



Neunmonatsbericht

01. Januar – 30. September 2006



KENNZAHLEN

in Mio. Euro	Q3/06	Q3/05	%uale Veränderung	9M/06	9M/05	%uale Veränderung
Auftragseingang	37,5	32,3	16,1%	115,0	84,2	36,6%
Auftragsbestand zum 30.09.	–	–	–	82,8	74,7	13,4%
Umsatz gesamt	31,3	27,1	15,7%	113,5	75,1	51,1%
Umsatzrendite	4,3%	-5,2%	–	10,0%	-11,7%	–
Rohertrag	14,0	11,9	17,9%	52,5	29,3	79,0%
Rohertragsmarge	44,7%	43,8%	–	46,2%	39,0%	–
Herstellungskosten	17,3	15,2	13,9%	61,0	45,8	33,3%
EBITDA	3,1	0,8	>100%	19,1	-1,7	>100%
EBITDA-Marge	10,0%	2,8%	–	16,8%	-2,3%	–
EBIT	1,7	-0,9	>100%	14,3	-7,0	>100%
EBIT-Marge	5,4%	-3,2%	–	12,6%	-9,3%	–
Ergebnis nach Steuern	1,4	-1,4	>100%	11,3	-8,8	>100%
Ergebnis je Aktie, verwässert	0,08	-0,09	>100%	0,65	-0,57	>100%
Eigenkapital	–	–	–	95,1	83,1	14,4%
Eigenkapitalquote	–	–	–	61,1%	50,3%	–
Eigenkapitalrentabilität	1,4%	-1,7%	–	11,9%	-10,6%	–
Bilanzsumme	–	–	–	155,7	165,4	-5,9%
Net Cash	–	–	–	14,1	6,0	>100%
Free Cash Flow	5,8	3,0	89,9%	6,9	0,3	>100%
Investitionen	1,6	1,0	52,2%	5,2	3,4	50,5%
Investitionsquote	5,0%	3,8%	–	4,6%	4,6%	–
Abschreibungen	1,4	1,6	-12,3%	4,8	5,2	-8,8%
Mitarbeiter zum 30.09.	–	–	–	741	662	11,9%



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort des Vorstands 2

GESCHÄFTSVERLAUF

Aktueller Stand des C4NP-Projekts 4

Substrat Bonder – sehr gute Perspektiven 5

Erstklassiger Service – zufriedene Kunden –

Testsysteme besonders erfolgreich 6

Umsatz- und Segmentbericht 7

Aktienbesitz von Organmitgliedern und diesen
nahe stehenden Personen 9

FINANZBERICHT

Konzerngewinn- und Verlustrechnung 10

Konzernbilanz 12

Konzern-Kapitalflussrechnung 14

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung 16

Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern 18

Segmentinformationen nach Regionen 18

Ausgewählte erläuternde Anhangsangaben 20



Konzernstruktur
Unternehmenskalender
Impressum / Kontakt



Dr. Stefan Schneidewind, Vorstandsvorsitzender



Stephan Schulak, Finanzvorstand

VORWORT DES VORSTANDS

LIEBE AKTIONÄRE, MITARBEITER UND GESCHÄFTSPARTNER DER SÜSS MICROTEC AG,

auch im dritten Quartal dieses Geschäftsjahres war die Geschäftsentwicklung weiterhin sehr zufriedenstellend. Insbesondere der Auftragseingang konnte mit 37,5 Millionen Euro erneut überzeugen. Dabei war die Steigerung des Ordervolumens im Segment Substrat Bonder besonders erfreulich; auch die Nachfrage nach Device Bondern stieg im dritten Quartal nochmals an. Im Segment Lithografie entwickelte sich der Auftragseingang im Vergleich zu den Vorquartalen zwar rückläufig – ist jedoch immer noch auf einem sehr guten Niveau. Aus regionaler Sicht fällt die positive Entwicklung in Europa und in Japan auf. Dies erklärt unter anderem auch das Wachstum bei den Substrat Bondern, denn in diesen beiden Regionen sind Großteile des Marktes Mikrosystemtechnik angesiedelt.

Da im zweiten Quartal 2006 unerwartet hohe Umsätze realisiert wurden, machten sich diese Verschiebungen erwartungsgemäß im dritten Quartal mit einem geringeren Umsatz in Höhe von 31,3 Millionen Euro bemerkbar (Q3/2005: 27,1 Millionen Euro). Somit wurde in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres ein Umsatz von 113,5 Millionen Euro erzielt verglichen mit 75,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Der Rohertrag betrug in den ersten neun Monaten 2006 52,5 Millionen Euro. Die Rohertragsmarge konnte von 39,0 Prozent in den ersten neun Monaten 2005 auf 46,2 Prozent gesteigert werden. Das EBIT erreichte 14,3 Millionen Euro, verglichen mit minus 7,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Aus dem Ergebnis nach Steuern von 11,3 Millionen Euro ergab sich ein Ergebnis pro Aktie von 0,65 Euro.

Zusammenfassend zeigen diese Kennzahlen die Stabilität der Rohertragsmarge und bestätigen wiederum die Funktionsfähigkeit der neuen Kostenstruktur sowie des Break-Even-Modells von SÜSS MicroTec.

Der Free Cash Flow entwickelte sich im Berichtszeitraum positiv (6,9 gegenüber 0,3). Gründe hierfür sind vor allem die Verringerung des Forderungsbestands und erhöhte Kundenanzahlungen. Wegen des hohen Auftragsbestands, insbesondere aufgrund der positiven Wachstumsdynamik bei den Substrat Bondern, wuchs das Lager auf 64,2 Millionen Euro an.

Auch in diesem Quartal hat das Segment „Lithografie“ wieder maßgeblich zu der positiven Geschäftsentwicklung beigetragen. SÜSS MicroTec-Coater, Mask Aligner und Developer sind insbesondere in den Märkten Advanced Packaging und Mikrosystemtechnik erfolgreich. Ansonsten ist die gute Auftrags- und Umsatzentwicklung in den Segmenten „Substrat Bonder“ (s. auch Seite 5) und „Device Bonder“ festzustellen. Über den aktuellen Stand des strategisch wichtigen C4NP-Projekts informieren wir Sie auf Seite 4 dieses Berichts.

Für das Gesamtjahr 2006 erwarten wir einen Umsatz von mindestens 150 Millionen Euro. Aufgrund der auch im dritten Quartal stabilen Entwicklung der Margen (insbesondere Dank der verbesserten Margensituation bei den Substrat Bondern) gehen wir dann von einer EBIT-Marge von mindestens zehn Prozent aus.

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, Sie sehen, wir werden das Geschäftsjahr 2006 mit einem deutlich positiven Ergebnis und gemäß den bisher gegebenen Prognosen abschließen.

Garching, im November 2006

Dr. Stefan Schneidewind
Vorstandsvorsitzender

Stephan Schulak
Finanzvorstand



▶ AKTUELLER STAND DES C4NP-Projekts

▶ Substrat Bonder –

Sehr gute Perspektiven

▶ Erstklassiger Service –

Zufriedene Kunden – Testsys-

tème besonders erfolgreich.

▶ Umsatz- und Segmentbericht

▶ Aktienbesitz der Organe

GESCHÄFTSVERLAUF

AKTUELLER STAND DES C4NP-Projekts

Seit Beginn des gemeinsamen Entwicklungsabkommens mit IBM haben SÜSS MicroTec und IBM an der optimalen Konfiguration für die Produktionslinie gearbeitet. So wurden auch technologische Änderungen in die Konstruktion des C4NP-Tools aufgenommen – und dies führte zu einer Ausweitung des gesamten Projekts mit entsprechenden Auswirkungen auf den Inbetriebnahmezeitplan. Wir verhandeln derzeit mit IBM über diese veränderten Rahmenbedingungen und erwarten, noch dieses Jahr einen angepassten Vertrag abzuschließen. Dieser neue Vertrag soll dem erheblich vergrößerten Projektumfang und den damit verbundenen höheren Aufwendungen seitens SÜSS MicroTec Rechnung tragen.

Eine der wichtigsten Änderungen des gemeinsamen Abkommens betrifft den „Ramp-up“ der C4NP-Linie bei IBM. Gegenwärtig ist vorgesehen, noch in 2006 einen halbautomatischen Produktionsprozess zu installieren, der dann im Verlauf des zweiten Quartals 2007 durch Lieferung finaler Komponenten zu einer vollautomatischen Stufe ausgebaut wird.

Wir erwarten, in 2007 weitere Aufträge für C4NP zu erhalten und sehen ein unverändert hohes Interesse seitens der Halbleiterindustrie an dieser neuen C4NP-Technologie. C4NP gewährleistet eine einzigartige Flexibilität bei den eingesetzten Lotmaterialien, inklusive bleifreier Lote. Dies ist für eine Vielzahl von Halbleiterprozessen von großer Bedeutung. Wir sind sicher, sobald die vollautomatische Produktionslinie bei IBM in Betrieb ist, hat C4NP das Potenzial einen bedeutenden Anteil des Wafer Bumping Markts zu gewinnen.

SUBSTRAT BONDER – SEHR GUTE PERSPEKTIVEN

Das Segment Substrat (oder auch Wafer) Bonder entwickelt sich sehr erfolgversprechend. Wafer Bonder werden im Markt Mikrosystemtechnik eingesetzt. Die relevanten Endprodukte sind zum Beispiel Sensoren für Airbags, GPS-Systeme, Reifendruck, Einparkhilfen, Regensensoren und Stabilitätsysteme in Kameras, Handys und in mobilen Spielekonsolen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Einsatzgebiete für Mikrosysteme, zum Beispiel: Rückprojektions-Beamer, Tintenstrahl-Druckköpfe und Biochips. Bei der Herstellung dieser Sensoren werden SÜSS MicroTec-Wafer Bonder in der Massenproduktion eingesetzt.

Beim Wafer Bonding-Prozess werden entweder zwei Wafer hochpräzise zueinander ausgerichtet und dann miteinander „verklebt“. Dieser Prozess wird bei der Produktion von Mikrosystemen benötigt, um Hohlräume herzustellen, in denen sich mechanische Teile bewegen können. Oder es wird ein bearbeiteter Wafer zu einer Glasplatte ausgerichtet und dann mit dieser „verklebt“. In diesem Fall dient die Glasplatte sozusagen als Deckel eines Mikrosystems.

Wafer Bonder von SÜSS MicroTec werden zudem in führenden Forschungs- und Entwicklungsinstituten eingesetzt. Kunden wie Nanoworld und Micralyne sind Technologieführer in der Mikrosystemtechnik. Mit derartigen Kunden hat SÜSS MicroTec das Ohr am Markt und somit die Chance, die Zukunft des Wafer Bondings mit zu gestalten. Durch die enge Zusammenarbeit mit diesen Forschungs- und Entwicklungsinstituten wissen wir um die zukünftigen Bedürfnisse unserer Produktionskunden und sind folglich in der Lage, diesen Anforderungen zu entsprechen.

Vor diesem Hintergrund wurde auch der neue „M-Lock“ Wafer Bonder entwickelt und anlässlich der SEMICON West im Juli vorgestellt. Die Besonderheit dieses Geräts ist eine Vakuumschleuse, die Kontaminationen auf

AKTUELLER STAND DES

C4NP-Projekts

SUBSTRAT BONDER –

SEHR GUTE PERSPEKTIVEN

▶ ERSTKLASSIGER SERVICE –

ZUFRIEDENE KUNDEN – TESTSYS-

TEME BESONDERS ERFOLGREICH

▶ UMSATZ- UND SEGMENTBERICHT

AKTIENBESITZ DER ORGANE

den zu bearbeitenden Wafern weitestgehend beseitigt. Dies ist in der Mikrosystem-Produktion extrem wichtig, da jede Verunreinigung den Yield (Ausbeute) der Produktion senkt. Daher müssen Produktionsgeräte einen möglichst hohen Yield erzielen. Entsprechend positiv wurde dieser „state-of-the-art“ M-Lock Wafer-Bonder auch von unseren Kunden aufgenommen. In diesem Segment erwartet SÜSS MicroTec in den kommenden Jahren eine deutliche Ausweitung des Geschäftsvolumens.

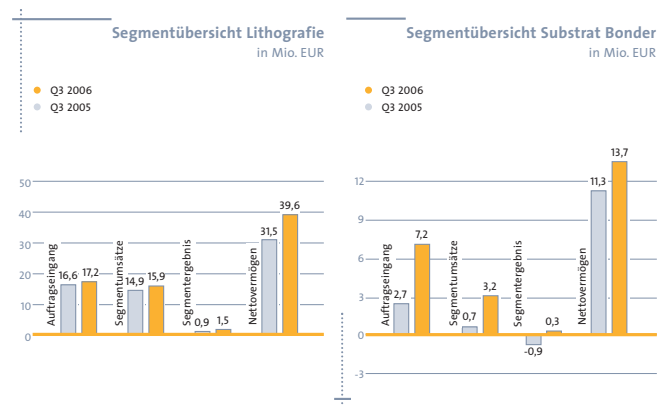
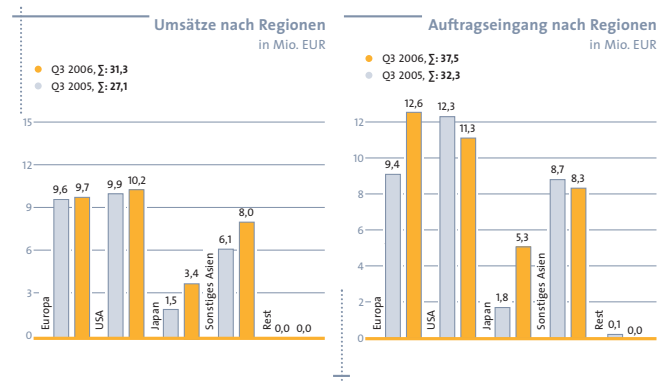
ERSTKLASSIGER SERVICE – ZUFRIEDENE KUNDEN – TESTSYSTEME BESONDERS ERFOLGREICH

Zufriedene Kunden sind Voraussetzung für Erfolg am Markt. VLSI Research Inc. führt jedes Jahr eine Umfrage in der Halbleiterindustrie durch. Basierend auf den Antworten werden dann in verschiedenen Kategorien die Equipment-Lieferanten mit der größten Kundenzufriedenheit ermittelt.

Seit vielen Jahren ist SÜSS bei den Gewinnern. So auch dieses Jahr mit einem hervorragenden ersten Platz in der Kategorie „Material Handling Equipment“ und einem siebten Platz in der Kategorie „Best Wafer Processing Equipment – Small Suppliers“.

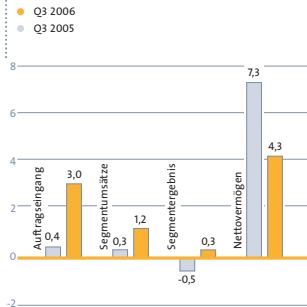
In der Kategorie „Material Handling Equipment“ sind hauptsächlich die SÜSS Test- und Prüfsysteme vertreten. Dieses Segment führte im Sommer ein neues Produkt in den Markt ein: Das „Blue-Ray Probe System“, ein Wafer-Tester, der bis zu 70.000 Chips in der Stunde testen kann. Diese Schnelligkeit ist insbesondere bei Testen von LEDs wichtig und bietet Kostenvorteile, da sich auf jedem Wafer Zehntausende LEDs befinden. Eine weitere Besonderheit dieses „Blue-Ray Probe Systems“ ist: Er kann beim Kunden vom halb- zum vollautomatischen System aufgerüstet werden. Somit kann das Gerät mit den Produktionsbedürfnissen unserer Kunden „mitwachsen“. Das macht es äußerst effizient und interessant – insbesondere bei unseren asiatischen Kunden.

Umsatz- und Segmentbericht

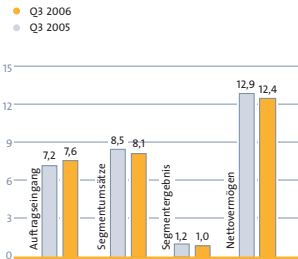


AKTUELLER STAND DES
C4NP-Projekts
Substrat Bonder →
Sehr gute Perspektiven
Erstklassiger Service →
Zufriedene Kunden = Testsys-
teme besonders erfolgreich
▶ Umsatz- und Segmentbericht
▶ Aktienbesitz der Organe

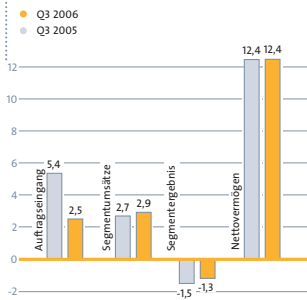
Segmentübersicht Device Bonder
in Mio. EUR



Segmentübersicht Test Systeme
in Mio. EUR



Segmentübersicht Sonstige
in Mio. EUR



AKTIENBESITZ VON ORGANMITGLIEDERN UND DIESEN NAHE
STEHENDEN PERSONEN ZUM 30.09.2006

Vorstand	Optionen	Aktien
Dr. Stefan Schneidewind	109.648	6.571
Stephan Schulak	120.286	13.000

Aufsichtsrat	Aktien
Dr. Winfried Süß	1.131.000
Gerhard Rauter	–
Dr. e. h. Horst Görtz	17.216
Peter Heinz	1.338
Prof. Dr. Anton Heuberger	–
Dr. Christoph Schücking	500

▶ GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
BILANZ
KAPITALFLUSSRECHNUNG
EIGENKAPITAL- VERÄNDERUNGSRECHNUNG
SEGMENTBERICHTERSTATTUNG
ANHANG

FINANZBERICHT

IFRS – KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR	01.07.06 – 30.09.06	01.07.05 – 30.09.05	01.01.06 – 30.09.06	01.01.05 – 30.09.05
Umsatzerlöse	31.340	27.093	113.458	75.073
Herstellungskosten	-17.328	-15.213	-60.991	-45.765
Bruttoergebnis vom Umsatz	14.012	11.880	52.467	29.308
Vertriebskosten	-5.402	-5.787	-17.317	-16.618
Forschungs- und Entwicklungskosten	-1.179	-2.199	-4.783	-5.926
Verwaltungskosten	-5.397	-5.039	-15.167	-15.988
Sonstige betriebliche Erträge	605	652	1.491	3.225
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-938	-377	-2.416	-957
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	0	0	0	-22
Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT):				
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)	3.126	755	19.061	-1.731
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	-1.425	-1.625	-4.786	-5.247
Operatives Ergebnis (EBIT)	1.701	-870	14.275	-6.978
Zinsaufwendungen	-154	-465	-712	-1.466
Zinserträge	108	73	348	398
Ergebnis vor Steuern	1.655	-1.262	13.911	-8.046
Ertragsteuern	-305	-158	-2.601	-758
Periodenergebnis	1.350	-1.420	11.310	-8.804
Davon Minderheitsanteile	52	6	94	-15
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre	1.298	-1.426	11.216	-8.789
Ergebnis je Aktie				
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	0,08	-0,09	0,67	-0,57
Verwässertes Ergebnis je Aktie in EUR	0,08	-0,09	0,65	-0,57

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

IFRS – KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR	01.01.06 – 30.09.06	01.01.05 – 30.09.05
Periodenergebnis	11.310	-8.804
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	3.023	2.934
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.763	2.313
Veränderung von At-equity bewerteten Beteiligungen	0	22
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	2	3
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	1.619	99
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	391	129
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplänen	263	363
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-199	-1.015
Zahlungsunwirksame Aufzinsung der Wandel- und Optionsanleihe	81	366
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	1.686	-1.607
Veränderung des Vorratsvermögens	-14.031	-1.168
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.993	11.327
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	-713	-408
Veränderung der Pensionsrückstellungen	89	-36
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	909	-2.435
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	24	1.320
Veränderung der latenten Steuern	-114	302
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	12.096	3.705

+ + + + +	Gewinn- und Verlustrechnung	+ + + + +
+ + + + +	Bilanz	+ + + + +
+ + + + +	Kapitalflussrechnung	+ + + + +
+ + + + +	Eigenkapital- und Veränderungsberechnung	+ + + + +
+ + + + +	Segmentberichterstattung	+ + + + +
+ + + + +	Anhang	+ + + + +

TEUR	01.01.06 – 30.09.06	01.01.05 – 30.09.05
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-1.668	-1.497
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-3.508	-1.943
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-5.176	-3.440
Aufnahme von Bankdarlehen	478	1.250
Tilgung von Bankdarlehen	-7.150	-2.077
Tilgung der Wandelanleihe	-3.622	0
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-1.691	930
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-54	317
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung	0	6.844
Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhung	0	-109
Einzahlungen aus der Ausübung von Bezugsrechten	12	148
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-12.027	7.303
Wechselkursbedingte Veränderung des Finanzmittelbestandes	-326	412
Veränderung der flüssigen Mittel	-5.433	7.980
Flüssige Mittel zum Jahresanfang	26.325	22.534
Flüssige Mittel zum Ende der Periode	20.892	30.514
Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	579	951
Zinseinnahmen während der Periode	348	398
Steuerzahlungen während der Periode	894	213
Steuererstattungen während der Periode	35	403



VORWORT	GESCHÄFTSVERLAUF	FINANZBERICHT	23
		GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	
		BILANZ	
		KAPITALFLUSSRECHNUNG	
		EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG	
		SEGMENTBERICHTERSTATTUNG	
		▶ ANHANG	

4. ÄNDERUNG VON SCHÄTZUNGEN

Soweit im Rahmen der Zwischenberichterstattungen Schätzungen vorgenommen wurden, bleiben diese grundsätzlich in der Methodik innerhalb des Geschäftsjahres und im Geschäftsjahresvergleich unverändert.

Abweichend von der Vorgehensweise zum Jahresende wird der Ertragsteueraufwand in jeder Zwischenberichtsperiode auf der Grundlage der besten Schätzung des gewichteten durchschnittlichen jährlichen Ertragsteuersatzes erfasst, der für das gesamte Geschäftsjahr erwartet wird.

Infolge vorgenommener Wertberichtigungen auf aktivierte Verlustvorräte in der Vergangenheit geht die SÜSS MicroTec AG derzeit von einem jährlichen Ertragsteuersatz aus, der deutlich unter dem erwarteten Ertragsteuersatz von rund 37% liegen wird.

Darüber hinaus gibt es keine berichtspflichtigen Änderungen mit einer wesentlichen Auswirkung auf die aktuelle Zwischenberichtsperiode.

5. SCHULDVERSCHREIBUNGEN ODER EIGENKAPITALTITEL

In der Berichtsperiode wurden keine Emissionen, Rückkäufe oder Rückzahlungen getätigt, weder bei Schuldverschreibungen noch bei sonstigen Eigenkapitaltiteln.

6. GEZAHLTE DIVIDENDEN

In der Berichtsperiode wurde weder eine Dividende ausgeschüttet noch zur Ausschüttung vorgeschlagen.

7. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH ENDE DER ZWISCHENBERICHTSPERIODE

Wesentliche berichtspflichtige Ereignisse nach Ende der Zwischenberichtsperiode haben sich nicht ergeben.

8. EVENTUALSCHULDEN UND EVENTUALFORDERUNGEN

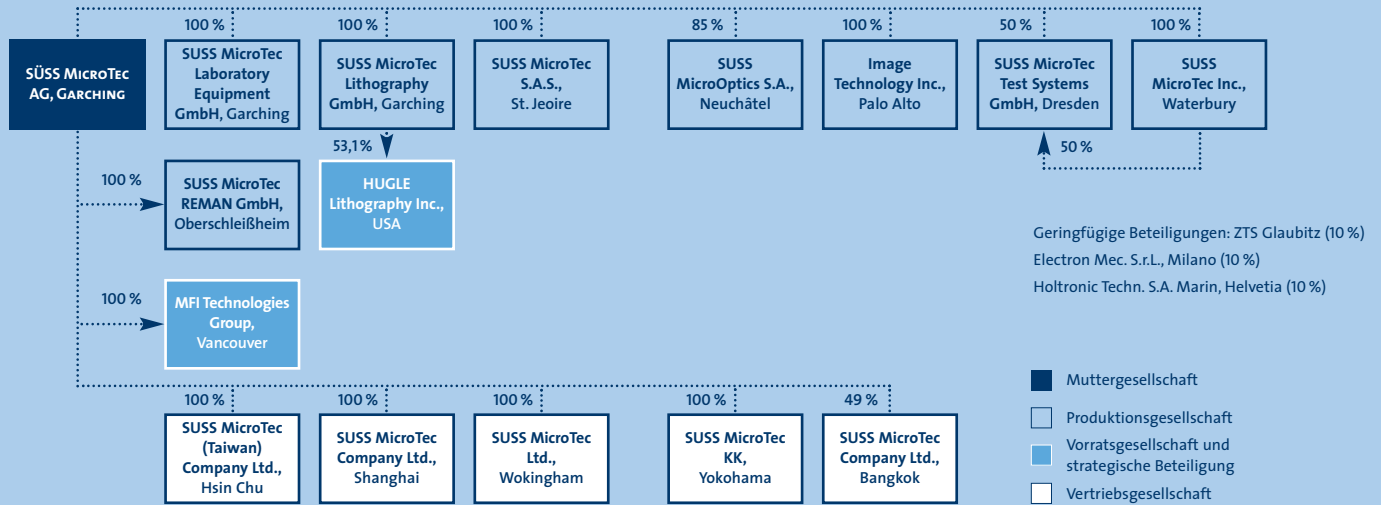
Eventualforderungen bestehen nicht. Bei den Eventualschulden sind keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Berichtszeitpunkt 31. Dezember 2005 erfolgt.

9. ERGEBNIS JE AKTIE

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich, indem der auf die Aktien entfallende Periodenüberschuss (nach Fremddanteilen) durch die durchschnittliche Zahl der Aktien dividiert wird.

Zur Ermittlung des verwässerten Ergebnisses je Aktie ist der den Aktionären (nach Fremddanteilen) zurechenbare Periodengewinn sowie der gewichtete Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien um die Auswirkungen aller verwässernden potenziellen Aktien anzupassen.

Konzernstruktur



UNTERNEHMENSKALENDER

Micromachine 2006	07. – 09. November	Tokio, Japan
SEMICON Japan	06. – 08. Dezember	Chiba, Japan

IMPRESSUM

Herausgeber: SÜSS MicroTec AG
Redaktion: Investor Relations, Group Accounting
Konzept und Gestaltung: IR-One AG & Co., Hamburg
Druck: Hartung Druck + Medien GmbH, Hamburg

KONTAKT

SÜSS MicroTec AG
 Schleißheimer Straße 90
 85748 Garching, Deutschland
 Fon: + 49 (0) 89 - 32007 - 0
 E-mail: info@suss.de

Investor Relations
 Fon: + 49 (0) 89 - 32007 - 314
 E-mail: ir@suss.de

Zukunftsorientierte Aussagen: Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft über-

nimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

- + www.suss.com -

|

